

「鏈結融資保證與科技市場媒合會」

工研院攜手中小企業信用保證基金，和全臺 26 家金融行庫組成的黃金三角專案。其有三大特色，第一，單一窗口，企業可直接透過工研院協助進行融資申請；第二，中小企業信用保證基金提供單一企業最高 2.2 億保證額度；第三，還有 3 多特點，分別是融資銀行多，全臺有 26 家銀行受理貸款；受惠企業多，5+2 新創重點產業之中小企業和新創公司皆可申請；技術專利多，工研院有超過 17,000 專利，讓企業技術鍍金又獲金援。

本次「鏈結融資保證與科技市場媒合會」係針對已經(或未來)與工研院技術合作、且有資金需求之科技企業，透過引入 26 家優質行庫的企業金融服務，提供具科技含量的創新企業與金融行庫互相認識與進行資金的供需交流，以扶植具產業潛力之本院新創公司或合作企業，並有效連結資本市場與科技市場，建立國內優質資金助攻產業發展的創新雙贏模式。備註：本媒合會訊息敬請協助轉知執行長、總經理、財務長.. 等公司融資評估相關人等

➤ **主辦單位：**工業技術研究院 技術移轉與法律中心

➤ **協辦單位：**財團法人中小企業信用保證基金

➤ **媒合銀行：**

台灣銀行、土地銀行、合庫商銀、第一商銀、華南商銀、彰化商銀、上海商銀、台北富邦、台灣企銀、京城商銀、瑞興商銀、新光銀行、陽信商銀、板信商銀、三信商銀、聯邦銀行、永豐商銀、玉山商銀、凱基商銀、星展商銀、台新商銀、中國信託、輸出入銀、兆豐銀行、國泰世華、高雄銀行

議程：

上午場 (9/24 台北場)

時間	議程
9:00~9:30	報到
9:30~10:00	開場致詞/專案介紹
10:00~11:00	媒合時間(上午場)
11:00~	自由交流/散會

下午場 (其他場次)

時間	議程
13:30~14:00	報到
14:00~14:30	開場致詞/專案介紹
14:30~15:30	媒合時間(下午場)
15:30~	自由交流/散會

場次	日期	時間	地點	報名截止日
新竹場	9/7(一)	下午場 13:30-15:30	新竹科學園區工業東二路1號 集思竹科會議中心4F羅西尼廳	9/2(三)
新北場	9/10(四)	下午場 13:30-15:30	新北市五股區五工六路9號 新北市勞工活動中心 402教室	9/7(一)
台中場	9/15(二)	下午場 13:30-15:30	臺中市大雅區中科路6號工研院 台中學習中心400會議室	9/10(四)
高雄場	9/17(四)	下午場 13:30-15:30	高雄市前鎮區成功二路25號 集思高雄亞灣會議中心301會議室	9/14(一)
台南場	9/21(一)	下午場 13:30-15:30	台南科學園區園區南科三路26號 2樓201會議室	9/16(三)
台北場	9/24(四)	上午場 9 : 00-12:00	臺北市信義路五段五號 世貿中心一館2樓第3會議室	9/21(一) 
		下午: 臺灣技術博覽會 (TIE) 開幕& 安排導覽團	https://tie.twtm.com.tw/WebPage/index.aspx	

有融資需求並有意參加本次媒合會之廠商，參閱各地場次與報名截止日，煩請於報名截止日前填寫下列出席問券表單，如無法開啟或有其他疑問，請與本案聯絡窗口聯繫或回覆至本信箱留下聯絡方式將由專人與您聯繫。

曾小姐 / 03-5916677 (siang@itri.org.tw)

周小姐/ 03-5916466(amanda_chou@itri.org.tw)

出席問券表單：

<https://forms.gle/a4obpG4TfJDtfq5K7>

QR CODE:

